

# 設計革新セミナの開催のご案内

## 第 547 回 (2025 年 5 月度) 例会

主催：東京設計管理研究会

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、当研究会に対しまして、格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、標記のセミナを下記要領にて開催いたしますので、ご多用のことと存じますがご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。

なお、セミナへの出欠の確認をさせていただきますので、返信メールにて **4月28日(月)必着** で、担当幹事までご連絡の程お願ひいたします。

敬具

記

1. 日 時 : 2025 年 5 月 14 日 (水) 14:30~17:00

2. 開催場所 : 下記会場オンサイト 及び Zoom オンライン併用による。

・オンサイト：NTT データエンジニアリングシステムズ 1F 第 6 応接室  
〒144-8601 東京都大田区西蒲田 7-37-10

グリーンプレイス蒲田

TEL : 03-5711-5316

<https://www.nttd-es.co.jp/company/branches/honsha.html>

・オンライン：Zoom URL は別途、担当幹事から前日までにご連絡いたします。

3. 設計革新セミナプログラム

(1) 会長挨拶 (14:30~14:40)  
(2) 発表 (14:40~16:30)

・テーマ：解析クラウドサービス「Simulation-Space」のご紹介  
・発表者：新事業企画室 営業部 営業課 川島 雅彦様  
・発表内容：クラウド型解析ソリューション「Simulation-Space」は、私たちが独自に構築したプラットフォームを基盤とし、5つの解析ソリューションをクラウド上で利用できるサービスです。ものづくりにおける良品を設計・製造するために必要なCAEを初期費用無し、インストールは必要なく、使いたいときに Simulation-Space のクラウド環境にアクセスするだけでご利用いただくことができます。このクラウドサービスについて事例を交えて、ご紹介させていただきます。

・テーマ：樹脂流動CAE “3D TIMON” のご紹介  
・発表者：東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社  
システム技術本部 CAE技術部 技術課 麻山 聰様  
・発表内容：射出成形品の成形不良である「ウェルドライン」、「そり変形」の原因と対策、CAEの活用事例をご紹介します。CAEによる成形トライの削減は、金型修正コスト削減や量産までのリードタイム短縮だけでなく、使用樹脂量や射出成形機の消費電力の削減などサステイナブルな環境にも貢献します。

(3) ディスカッション (16:30~17:00)

4. 懇親会 (17:30~19:30)

★有志参加による懇親会開催予定（有料5,000円程度）  
ご出席が可能な皆様は、是非ご参加ください。  
セミナー参加連絡の際、懇親会の出欠もご一報ください。  
場所：JR蒲田駅周辺

★★ 5月度出欠連絡 ★★

出欠のご連絡は、電子メールにて**4月28日（月）**までに担当幹事へお願ひいたします。  
なお、その際、参加を希望される方は、  
**ご氏名、勤務先、メールアドレス、参加方法（会場又はWeb）、懇親会出欠**を必ずご記入ください。  
【5月度担当幹事】西村 勇三

会場へのアクセス

JR 蒲田駅下車。西口を出てバス通りを直進してください。  
突き当りまで行くと右手に緑色のビルがあります。  
JR「蒲田駅」西口より徒歩8分  
東急池上線「蓮沼駅」より徒歩2分

<https://www.nttd-es.co.jp/company/branches/honsha.html>